

NIKAFLEX®

ポリイミドフィルム基材カバーレイ用フィルム
Polyimide Film base coverlay

C-series

型式
Model

C IS V

特徴 Characteristics

- **はんだ耐熱性に優れ、フローソルダー工程に十分に耐える事ができますので、広範囲の電子機器部品に使用可能**

Because of excellent resistance to solder temperature, it bears up against flow-soldering process and is used consequently for a wide range of parts of high-class electronic equipment.

- **電気特性に優れる**

Excellent electrical characteristics.

- **可撓性に優れる**

Excellent flexibility.

- **プレス時の樹脂流れが少ない**

Little resin-flow while pressing.

標準製品仕様

Specifications of standard Products

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------|
| ベースフィルム厚さ (μm) Thickness of Base Film | | 12.5, 25, 50 |
| 接着剤 Adhesive | 種類 Classification | 熱硬化性樹脂 Thermosetting Resin |
| | 厚さ (μm) Thickness | 15, 25, 35 |
| 接着剤面の保護材 Releasing Material on Adhesive Surface | | 剥離紙 Release Paper |
| 標準サイズ (mm) Standard Size | | 500×Roll (100m) |

UL Recognition (FILE No:E46785)

使用上の注意点 Caution

- 1 接着剤は半硬化となっておりますので、常温で放置しておきますと接着剤の硬化が急速に進行致しますので、保管は低温(5℃以下)、湿度 80%以下で管理して下さい。
Time and temperature rapidly promote a change from the semicured to the fully cured adhesive state, so keep C IS V at 5°C or below and at 80%RH or below.
- 2 保証期間は未開封の状態での製造後 6 カ月です。
Guaranteed period for C IS V before unpacked is 6 months after manufacture.
- 3 プレスパッドとして紙を使用する場合、紙中水分により接着剤が劣化し、接着剤とフィルムが剥離する場合がありますので使用前にご確認ください。
Moisture in press pads made of paper might make adhesiveness weaker and cause delamination of adhesive and polyimide film. If paper is used as press pads, be sure to check condition of press pads paper before using that.

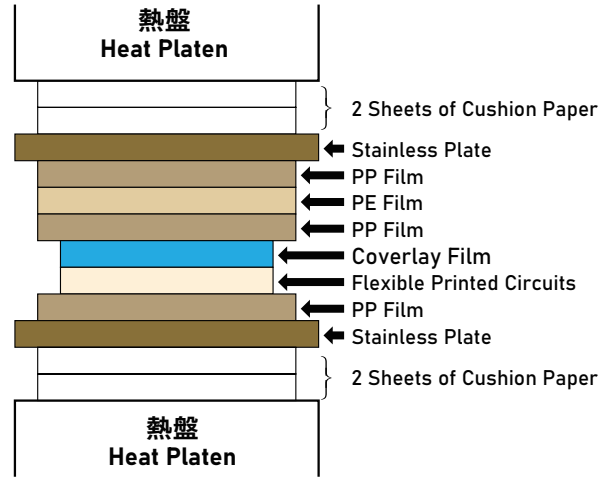
加工方法例

An Example of Processing Method

プレス手順 Procedures (Press-Bonding)

- 1 常温セット
Setting at room temp.
- 2 エアー抜き 5 回程度
Removing Air (about 5 times)
- 3 圧力セット(2 ~ 4MPa)
Apply pressure (2 to 4 MPa)
- 4 温度上昇
Temp. Elevation
- 5 100℃位になった時点で再度エアー抜き
Removing Air again at 100℃
- 6 圧力セット(2 ~ 4MPa)
Apply pressure (2 to 4 MPa)
- 7 140℃ ~ 160℃位になった時点で再度エアー抜き
Removing Air again at 140℃ ~ 160℃
- 8 160℃、2 ~ 4MPa、40 ~ 60 分セット
Press-bonding at 160℃ under pressure of 2 ~ 4MPa for 40 to 60 min.
- 9 冷却
Cooling
- 10 取出し
Taking out

プレスセット例 Materials assembly for Press-bonding



性能表

Characteristic

ポリイミドフィルム 25μm、接着剤厚さ 35μm、C IS V 2535(DB)
Model No. C IS V 2535 (DB) (Polyimide Film 25μm, Adhesive 35μm)

| 試験項目 Test item | 単位 Unit | 処理条件 Treatment conditions | 標準値 (平均) Standard Value | 保証値 (平均) Guaranteed Value | 試験方法 Test Method |
|----------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| 接着剤フロー Resin Flow | mm | A | 0.18 | 0.20 以下 (Max.) | 弊社方式 Our Standard |
| 表面抵抗率 Surface Resistivity | Ω | C-96/20/65 | 3.0×10 ¹⁶ | 5.0×10 ¹⁰ 以上 (Min.) | JIS C 6481 |
| | | C-96/40/90 | 2.2×10 ¹⁶ | 1.0×10 ¹⁰ 以上 (Min.) | |
| 体積抵抗率 Volume Resistivity | Ω-cm | C-96/20/65 | 1.2×10 ¹⁶ | 1.0×10 ¹² 以上 (Min.) | JIS C 6471 |
| | | C-96/40/90 | 4.6×10 ¹⁶ | 5.0×10 ¹⁰ 以上 (Min.) | |
| 引きはがし強さ Peel Strength | N/mm | A | 1.0 | 0.7 以上 (Min.) | JPCA-BM-02 |
| | | E-1/180 | 0.9 | 0.6 以上 (Min.) | |
| はんだ耐熱性 Solder Heat Resistance | — | 280℃/10sec. | 異常なし No change in appearance | ふくれ、或いははがれ が生じてはならない No delamination and blister | IPC-FC-232B |
| 耐熱性 Heat Resistance | — | E-24/130 | 異常なし No change in appearance | | JIS C 6481 |
| 耐薬品性 Chemical Resistance | — | 23℃/10min. | 異常なし No change in appearance | | JPCA-BM-02 |

NOTE (1) 接着剤フロー、引きはがし強さ、はんだ耐熱性、耐熱性、耐薬品性は電解銅箔 35μm(1 オンス)の光沢面と接着剤面を合わせプレスした値です。
Values of resin flow, peel strength, solder resistance, heat resistance and chemical resistance are those of laminate obtained by pressbonding the untreated side of electrolytic copper foil (35μm, 1 ounce) with C IS V 2535 (PB).

(2) プレス条件/温度：160℃、時間：40分、成形圧力：4MPa
Press conditions: 160℃/40min./molding pressure 4MPa